

Verbund-Entlötspitze Chip 3L - Hakko T16-1013

Artikel-Nr. HK-T16-1013

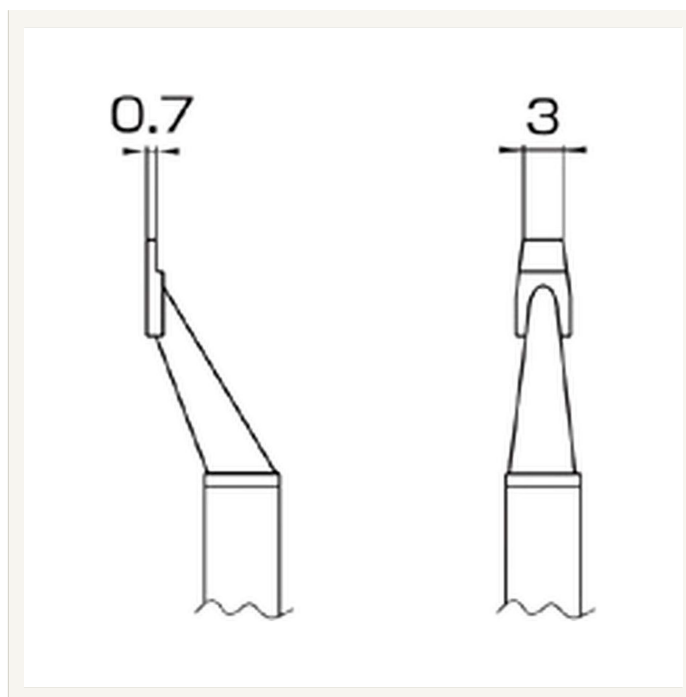
Hersteller Hakko

EAN 4962615028175

Verbund-Entlötspitze im 3L-Format für den Einsatz mit der Hakko FM 2022 Parallelpinzette. Die Packung enthält 2 Ersatzspitzen für die präzise Bauteilentfernung und Rework-Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T16-1013 ist eine Verbund-Entlötspitze im 3L-Format, die speziell für den Einsatz mit dem Parallelpinzetten-System FM 2022 entwickelt wurde. Diese Packung enthält 2 Ersatzspitzen für das effiziente und präzise Entlöten von SMD- und THT-Bauteilen.

HAUPTMERKMALE

- Verbundkonstruktion für höhere Langlebigkeit und verbesserte thermische Leistung
- 3L-Format, optimiert für den Betrieb mit Parallelpinzetten
- Kompatibel mit dem Hakko FM 2022 Entlötsystem
- ESD-sicheres Design für die Handhabung empfindlicher Bauteile
- 2er-Pack für eine verlängerte Betriebsdauer
- Präzisionsgefertigt für zuverlässiges Entlöten

ANWENDUNGEN

Ideal für das präzise Entlöten und Rework von SMD-Bauteilen, integrierten Schaltkreisen und anderen empfindlichen elektronischen Komponenten. Geeignet für Reparatur, Prototyping und Fertigungsumgebungen, die ein zuverlässiges Entlöten erfordern.

LIEFERUMFANG

- 2 × Verbund-Entlötpitze Chip 3L